

## 出展料金

区分		1小間 / 7.5m <sup>2</sup> ( ) 内は税込金額
一般		375,000円 (412,500円)
会員企業*1	通常	320,000円 (352,000円)
	早期	300,000円 (330,000円)
	早期大小間 (20小間以上)	280,000円 (308,000円)

\*1 対象：JPCA会員 / JIEP正会員・賛助会員 / JARA正会員・賛助法人会員 / JEP・TEP正会員  
 ※小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料金、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。  
 ※1小間あたりの面積は従来の9m<sup>2</sup>から7.5m<sup>2</sup>に変更となります。  
 ※7.5m<sup>2</sup>：間口3m×奥行2.5m

## 申込方法

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)  
 同封の出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込みください。  
 貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。  
 出展申込書を受理次第、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします。(原則会期前振込) オンラインにてお申込みいただいた場合は、請求書を出展者専用webよりダウンロードが可能になります。

## 申込締切

早期申込締切日 ※会員企業は早期金額が適用	2019年11月29日(金)
最終申込締切日	2020年1月31日(金)

※予定の小間数に達した場合、締切らせていただきます事を予めご了承ください。

## 取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
2020年2月1日(土)まで	小間料金の50%
2020年2月2日(日)以降	小間料金の100%

## 開催までのスケジュール(予定)

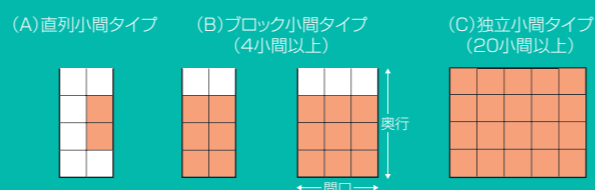
2019年11月	12月	2020年1月	2月	3月	4月	5月
11月29日(金) ▲ 早期出展申込み切		1月31日(金) ▲ 出展申込み切	2月18日(火) ▲ 出展者説明会(東京)  2月20日(木) 出展者説明会(大阪)		4月上旬 招待状配布  4月下旬 各種提出書類期限 来場事前登録開始	5月25日(月)～26日(火) 搬入期間  5月27日(水)～29日(金) 展示会開催 10:00～17:00 ※最終日即日撤去

## 【本年の開催は青海展示棟となります。】

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にともない、会場利用が制限されます。  
 2020年展の展示面積は昨年の約80%まで縮小します。できるだけ多くの皆様にご出展いただくため、過去の出展最大小間数からの増小間をご遠慮いただくことがあります。また、お申込多数の場合は、1社あたりの小間数を制限させていただく場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

- 1小間あたりの面積について**：1小間あたりの面積は従来の9m<sup>2</sup>から7.5m<sup>2</sup>に変更となります。
- フロアレイアウトについて**：フロアレイアウトについては、決まり次第展示会ウェブサイトにてご案内いたします。
- 小間位置の決定**：出展小間数、過去の出展履歴、会員/非会員などをもとに主催者が決定し、出展者説明会で発表します。
- ブース造作について**：効率的な設営/撤去を実現するために、パッケージブースのご利用にご協力をお願いします。詳細は別途出展者説明会でご案内いたします。
- 車両搬入出について**：トラックヤードが大変狭いため、4t車の利用を推奨いたします。

## 小間形態



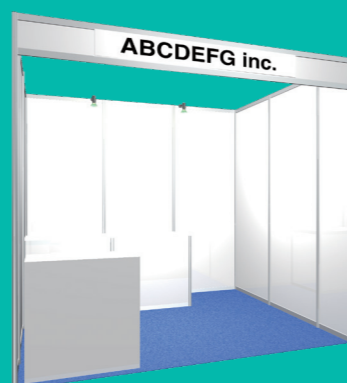
※小間タイプのご希望に添い加える場合もありますので、予めご了承ください。  
 ※角小間のご希望は承っておりませんので、予めご了承ください。

## 出展者サポートプログラム **有料・オプション**

バーコードリーダーサービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。  
 ※詳細は別途出展者説明会でご案内いたします。

## パッケージブースプランのご案内

**参考** 価格：¥73,000 (消費税別/※予定)  
 素材：システムパネル  
 ※パッケージブースの料金は参考価格です。  
 ※図はイメージです。



JPCA Show

JIEP マイクロエレクトロニクスショー

JISSO PROTEC

第50回国際電子回路産業展

第34回最先端実装技術・パッケージング展

第22回実装プロセステクノロジー展

有機デバイス総合展  
IoT対応半導体・回路基板展

WIRE Japan Show  
電気・光伝送技術展

Smart Sensing  
スマートセンシング

JEP/TEP Show  
JEP 全国電子部品流通連合会  
東京電機卸商業協同組合

E-Textile  
イーテキスタイル展



のせる つなぐ つくる そして ひろげる

5.27(水) ▶ 5.29(金) 10:00-17:00

東京ビッグサイト 青海展示棟 全ホール+TFTホール

5G、自動車、IoT、ロボット、ウェアラブル等を具現化する技術の総合展示会

電子機器2020  
トータルソリューション展

出展の  
ご案内

www.jpccashow.com

本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会  
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階  
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpcg.org

運営事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン  
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング  
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ

主催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人日本ロボット工業会  
 共催：電子デバイス産業新聞 [(株)産業タイムズ社]、電線新聞 [(株)工業通信]、(株)JTBコミュニケーションデザイン、全国電子部品流通連合会/東京電機卸商業協同組合、福井県e-テキスタイル製品開発研究会  
 後援(予定)：経済産業省

海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体  
 中国電子回路行业协会 (CPCA)、欧州電子回路協会 (EIPC)、印度電子工業会 (ELCINA)、香港線路板協会 (HKPCA)、米国電子回路協会 (IPC)、印度電子回路工業会 (IPCA)、韓国電子回路産業協会 (KPCA)、台湾回路板協会 (TPCA)

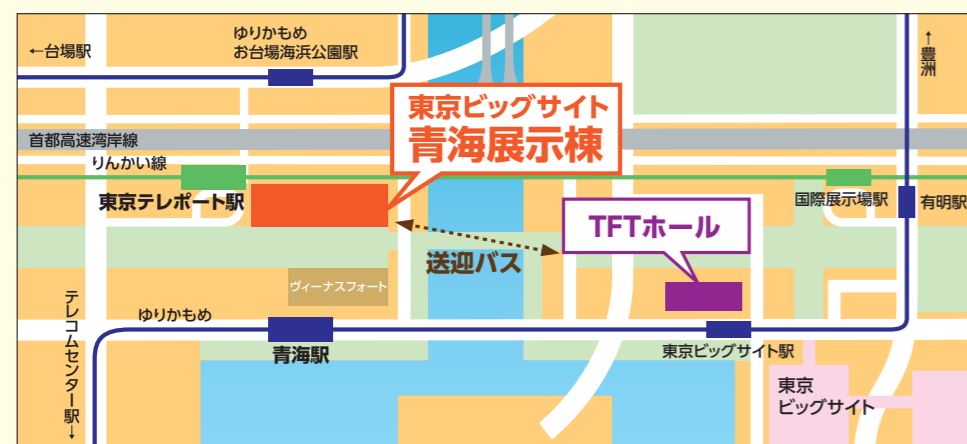
# 5G、自動車、IoT、ロボット、ウェアラブル等を 具現化する技術の総合展示会



電子機器2020  
トータルソリューション展  
www.jpccashow.com

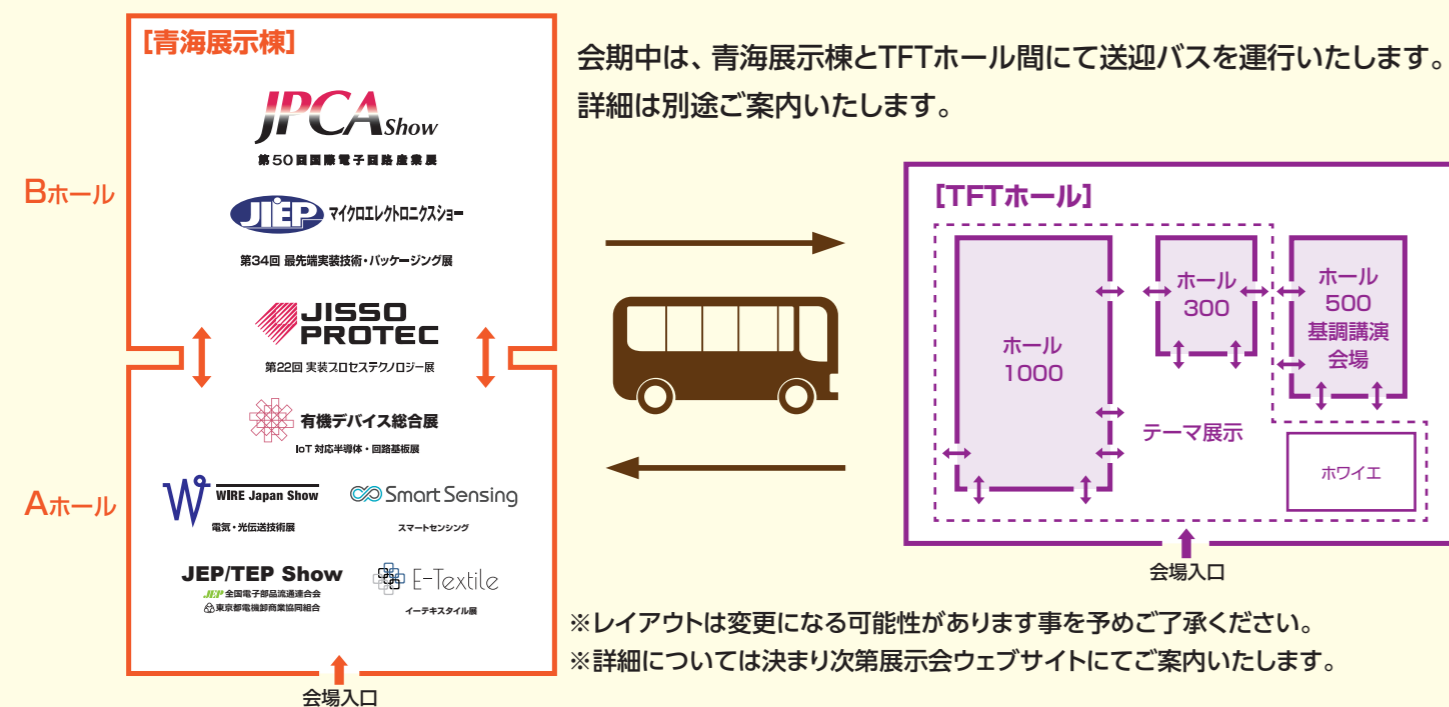
エレクトロニクス展示会の中でも専門性・注目度が高く、広く国内外からも多くの来場者を迎え、活発な商談の場としてご利用いただいています。

## 青海展示棟 / TFTホール アクセス



- 青海展示棟 最寄り駅**
- ゆりかもめ「青海駅」下車徒歩約4分
  - りんかい線「東京テレポート駅」下車徒歩約2分
- TFTホール 最寄り駅**
- ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」下車徒歩約1分
  - りんかい線「国際展示場駅」下車徒歩約5分

## 展示会場レイアウト案



## 2019年開催実績

- 会場** 東京ビッグサイト 西ホール+会議棟
- 出展規模** 507社 / 1,372小間
- 来場者数** 44,110名
- セミナー聴講数** 11,421名

無料

## 出展者 (NPI) プレゼンテーション

ご出展をより効果的にお使いいただくため、ご利用下さい。  
パネルやポスター等では伝えきれない情報のPRに!!

- セミナー会場 (30分の講演) 青海展示棟内
- 発表用機器完備

※詳細は別途ご案内いたします。  
※講演日時は、申込みの早い順に選択可能です。

## 主な調達側来場企業

- 自動車関連 アイシン精機、朝日電装、市光工業、カルソニックカンセイ、ケーヒン、KOA、小糸製作所、スタンレー電気、住友電装、ダイハツ工業、デンソー、東海理化、東洋電装、トヨタ自動車、日産自動車、日本精工、日本発条、パイオニア、日立オートモティブシステムズ、日野自動車、プリチストン、SUBARU、本田技研工業、マツダ、三菱自動車工業、矢崎部品
- OA・ロボティクス オムロン、キーエンス、キャノン、コニカミノルタ、サイバーダイン、山洋電気、JUKI、セイコーエプソン、パナソニック、パナソニックスマートファクトリーソリューションズ、ファナック、FUJI、富士ゼロックス、三菱電機、安川電機、ヤマハ発動機、リコーインダストリー、リコージャパン
- 情報・通信関連 アップル、伊藤忠テクノソリューションズ、インテル、NHKメディアテクノロジー、NTT、NTTドコモ、沖電気工業、韓国放送公社 (KBS)、京セラ、KDDI、ソフトバンク、東京放送ホールディングス (TBS)、東芝情報システム、日本IBM、日本サムスン、日本電気、日本マイクロソフト、日本ユニシス、パナソニック、PFU、日立製作所、Huawei、フジクラ、富士通、村田製作所
- AV・家電関連 アイリスオーヤマ、LGエレクトロニクス、カシオ計算機、キャノン、Samsung Electronics、シャープ、ソニー、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、ダイキン工業、TOTO、ニコン、パイオニア、パナソニック、富士通ゼネラル、ヤマハ、ローランド
- 医療機器関連 旭化成、イーザイ、オリンパス、キャノンメディカルシステムズ、Siemens、島津製作所、白河オリンパス、テルモ、日立ハイテクノロジー、日立ヘルスケア・マニュファクチャリング、富士フイルム、マーク電子、モリタ東京製作所
- 半導体デバイス関連 インテル、STマイクロエレクトロニクス、キャノン、サムスン電子、SCREENホールディングス、ソニー、TDK、東京エレクトロン、東芝メモリ、ニコン、日立ハイテクノロジー、富士通セミコンダクター、マイクロンジャパン、ルネサスエレクトロニクス、ローム
- 航空・宇宙関連 IHI、NECスペーステクノロジー、JAXA (宇宙航空研究開発機構)、シンフォニアテクノロジー、ナブテスコ、成田エアポート、日本アビオニクス、日本電気、三菱重工業、三菱電機
- その他 海上自衛隊、関西電力、陸上自衛隊、東京ガス、東京電力ホールディングス、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道、みずほ銀行
- 電子回路基板 アドバンテスト、イースタン、イビデン、エルナー、協栄産業、京写、京セラ、キョウデン、シライ電子工業、伸光製作所、新光電気工業、住友電工プリントサーキット、大昌電子、日東電工、日本シイエムケイ、日本メクトロン、パナソニック、日立化成、フジクラ、富士通インターコネクトテクノロジーズ、堀場製作所、メイコー、山下マテリアル、利昌工業

## 構成展示会・出展対象

電子回路技術	高密度実装技術	電子部品実装技術	新規回路形成技術	電気・光伝送技術	センサー技術	半導体・電子部品	NEW 高性能テキスタイル
<p><b>JPCA Show</b> 第50回国際電子回路産業展</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●プリント配線板技術展 製品 (電子回路基板等の電子機器)、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム</li> <li>●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵に関する技術全般 (製品/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</li> <li>●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する技術全般 (製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</li> <li>●機器・半導体受託生産システム展 EMS等の電子電気機器及び半導体に関する受託サービス全般 (製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</li> </ul> <p>【主催：一般社団法人日本電子回路工業会】</p>	<p><b>JIEP</b> マイクロエレクトロニクスショー 第34回 最先端実装技術・パッケージング展</p> <p>実装・電子技術に関する技術全般 (材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)</p> <p>【主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会】</p>	<p><b>JISSO PROTEC</b> 第22回 実装プロセステクノロジー展</p> <p>電子部品実装に関する技術全般 (電子部品実装機・システム/半導体実装機器・システム/検査技術・システム/実装設計システム/各種ロボット等)</p> <p>【主催：一般社団法人日本ロボット工業会】</p>	<p><b>有機デバイス総合展</b> IoT対応半導体・回路基板展</p> <p>有機デバイスに関する技術全般 (プリンテッドエレクトロニクス製品・部品/MEMS/センサーLED/OLED/有機半導体関連応用製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等)</p> <p>【共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞 ((株) 産業タイムズ社)】</p>	<p><b>WIRE Japan Show</b> 電気・光伝送技術展</p> <p>ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般 (産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間 (M2M) 伝送/光伝送等)</p> <p>【共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞 ((株) 工業通信)】</p>	<p><b>Smart Sensing</b> スマートセンシング</p> <p>センサー及びセンシングシステムに関する技術全般 (センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)</p> <p>【共催：一般社団法人日本電子回路工業会・株式会社JTBコミュニケーションデザイン】</p>	<p><b>JEP/TEP Show</b> JEP 全国電子部品流通連合会 東京部電機卸商業協同組合</p> <p>半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般 (半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)</p> <p>【共催：一般社団法人日本電子回路工業会・全国電子部品流通連合会・東京都電機卸商業協同組合】</p>	<p><b>E-Textile</b> イーテキスタイル展</p> <p>電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル (スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術) に関する技術全般 (繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)</p> <p>【共催：一般社団法人日本電子回路工業会・福井県e-テキスタイル製品開発研究会】</p>